

[ホーム](#) > [プレスリリース](#) > [プレスリリース \(2012年\)](#) > 日本ゼオンとIBM、高速シリアル伝送技術に関する共同開発を発表

日本ゼオンとIBM、高速シリアル伝送技術に関する共同開発を発表

2012年5月9日


日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、社長：古河 直純）は、International Business Machines Corporation（本社：米国ニューヨーク州アーモンク、CEO：バージニア・M・ロメッティ、以下IBM）との間で、次世代メインフレームコンピューター向けの高速シリアルリンク（*1）（>25Gbps）を達成すべく、新規プリント配線板の共同研究開発に合意したと発表した。

近年、インターネットを中心としたデータ通信がクラウドコンピューティングを介して利用されるようになってきており、その中枢を担うメインフレームコンピューターは、スマートフォンに代表される携帯情報端末の急速な普及や、フェイスブックやツイッターのようなSNSを中心としたインターネット利用環境の変化により、ますます高い情報処理能力を求められるようになってきている。

日本ゼオンは、次世代メインフレームコンピューターを主要ターゲットとした新規プリント配線板用絶縁材料（ZEONIF™ XL-Series）の開発を進めており、革新的技術でメインフレームコンピューター市場を牽引しているIBMとの共同開発を推進することにより、次世代の高速シリアルリンクに求められる高い技術障壁のブレークスルーが可能になると期待される。

日本ゼオンは技術者を米国ニューヨーク州のYorktown HeightsにあるIBMのThomas J. Watson研究所に派遣し、共同開発を進めていく。

（*1）高速シリアルリンク：伝送路上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送る方式であり、現状の速度は10Gbps以下である。

 本件に関するお問い合わせ

日本ゼオン株式会社 CSR統括部門 広報室
Tel : 03-3216-2747

[▶ お問い合わせフォーム](#)

© ZEON CORPORATION. All rights reserved.